

股票简称:博敏电子 股票代码:603936 上市地点:上海证券交易所



博敏电子股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案

二〇二〇年四月

公司声明

1、博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“博敏电子”)及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

2、本预案为公司经营与收益的变化,由发行人自行负责;因本次发行引致的投资风险,由投资者自行承担。

3、本预案是公司董事会对本次发行的说明,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

特别提示

1、有关本次发行的相关事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,本次发行尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施。

2、本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象将在中国证监会关于本次发行核准批复后,由董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。若国家法律、法规对本次发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

3、本次发行的数量不超过本次发行前公司总股本 315,038,283 股数的 30%,即不超过 94,511,484 股(含本数)。

若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生增发、资本公积转增股本或因其他原因导致发行人前次发行前总股本发生变动的,本次发行的股份数量上限作相应调整。最终发行股份数量由公司股东大会根据股东大会的授权,于发行时根据实际发行情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

4、本次发行的定价基准日为发行期的首日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,本次发行的发行底价将进行相应调整。

本次发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规和规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况,以竞价方式确定。

5、发行对象认购的本次发行的股份,自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让;本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

6、在本次发行完成后,由新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。

7、本次发行决议的有效期自本次发行前公司的滚存未分配利润、滚存未分配利润、滚存未分配利润、滚存未分配利润之日起 12 个月止。

8、本次发行募集资金总额为不超过 124,477.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	54,031.00
2	高端印刷电路板生产技改项目	34,925.88	32,048.52
3	研发中心升级项目	5,569.92	5,398.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
	合计	132,383.76	124,477.52

本次发行募集资金总额不超过 124,477.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	54,031.00
2	高端印刷电路板生产技改项目	34,925.88	32,048.52
3	研发中心升级项目	5,569.92	5,398.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
	合计	132,383.76	124,477.52

本次发行募集资金总额不超过 124,477.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	54,031.00
2	高端印刷电路板生产技改项目	34,925.88	32,048.52
3	研发中心升级项目	5,569.92	5,398.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
	合计	132,383.76	124,477.52

本次发行募集资金总额不超过 124,477.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	54,031.00
2	高端印刷电路板生产技改项目	34,925.88	32,048.52
3	研发中心升级项目	5,569.92	5,398.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
	合计	132,383.76	124,477.52

本次发行募集资金总额不超过 124,477.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	54,031.00
2	高端印刷电路板生产技改项目	34,925.88	32,048.52
3	研发中心升级项目	5,569.92	5,398.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
	合计	132,383.76	124,477.52

本次发行募集资金总额不超过 124,477.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	54,031.00
2	高端印刷电路板生产技改项目	34,925.88	32,048.52
3	研发中心升级项目	5,569.92	5,398.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
	合计	132,383.76	124,477.52

本次发行募集资金总额不超过 124,477.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	54,031.00
2	高端印刷电路板生产技改项目	34,925.88	32,048.52
3	研发中心升级项目	5,569.92	5,398.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
	合计	132,383.76	124,477.52

本次发行募集资金总额不超过 124,477.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	54,031.00
2	高端印刷电路板生产技改项目	34,925.88	32,048.52
3	研发中心升级项目	5,569.92	5,398.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
	合计	132,383.76	124,477.52

本次发行募集资金总额不超过 124,477.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	54,031.00
2	高端印刷电路板生产技改项目	34,925.88	32,048.52
3	研发中心升级项目	5,569.92	5,398.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
	合计	132,383.76	124,477.52

本次发行募集资金总额不超过 124,477.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	54,031.00
2	高端印刷电路板生产技改项目	34,925.88	32,048.52
3	研发中心升级项目	5,569.92	5,398.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
	合计	132,383.76	124,477.52

本次发行募集资金总额不超过 124,477.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	54,031.00
2	高端印刷电路板生产技改项目	34,925.88	32,048.52
3	研发中心升级项目	5,569.92	5,398.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
	合计	132,383.76	124,477.52

本次发行募集资金总额不超过 124,477.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	54,031.00
2	高端印刷电路板生产技改项目	34,925.88	32,048.52
3	研发中心升级项目	5,569.92	5,398.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
	合计	132,383.76	124,477.52

本次发行募集资金总额不超过 124,477.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	54,031.00
2	高端印刷电路板生产技改项目	34,925.88	32,048.52
3	研发中心升级项目	5,569.92	5,398.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
	合计	132,383.76	124,477.52

本次发行募集资金总额不超过 124,477.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	54,031.00
2	高端印刷电路板生产技改项目	34,925.88	32,048.52
3	研发中心升级项目	5,569.92	5,398.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
	合计	132,383.76	124,477.52

本次发行募集资金总额不超过 124,477.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	54,031.00
2	高端印刷电路板生产技改项目	34,925.88	32,048.52
3	研发中心升级项目	5,569.92	5,398.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
	合计	132,383.76	124,477.52

本次发行募集资金总额不超过 124,477.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	54,031.00
2	高端印刷电路板生产技改项目	34,925.88	32,048.52
3	研发中心升级项目	5,569.92	5,398.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
	合计	132,383.76	124,477.52

本次发行募集资金总额不超过 124,477.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	54,031.00
2	高端印刷电路板生产技改项目	34,925.88	32,048.52
3	研发中心升级项目	5,569.92	5,398.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
	合计	132,383.76	124,477.52

本次发行募集资金总额不超过 124,477.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	54,031.00
2	高端印刷电路板生产技改项目	34,925.88	32,048.52
3	研发中心升级项目	5,569.92	5,398.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
	合计	132,383.76	124,477.52

本次发行募集资金总额不超过 124,477.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	54,031.00
2	高端印刷电路板生产技改项目	34,925.88	32,048.52
3	研发中心升级项目	5,569.92	5,398.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
	合计	132,383.76	124,477.52

本次发行募集资金总额不超过 124,477.52 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	54,031.00
2	高端印刷电路板生产技改项目	34,925.88	32,048.52
3	研发中心升级项目	5,569.92	5,398.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
	合计	132,383.76	124,477.52

成立日期:2005年3月25日
上市时间:2015年12月9日
注册资本:315,038.83 万元

法定代表人:徐锋
注册地址:梅州市经济开发区东升工业园
办公地址:梅州市经济开发区东升工业园
邮政编码:517478

联系电话:(0753)-2329896
公司传真:(0753)-2329836
公司网址:www.bominde.com
电子邮箱:zqb@bominde.com

经营范围:研发、制造、销售:双面、多层、柔性、高频、HDI 印刷电路板等新型电子元器件;电路板表面处理;封装;货物的进出口、技术进出口;投资;不动产及机器设备租赁;软件的设计、开发、技术服务和咨询;网络通讯科技产品、工业自动化设备、低压电器生产、加工、销售;电子材料的研发、生产和销售;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、本次发行的背景和意义

1、本次发行的背景

1)PCB 行业保持高速增长,我国市场增长迅速

PCB 是承载电子元器件并连接电路的载体,有“电子产品之母”之称,是现代电子产品中不可缺少的元器件。PCB 行业作为电子信息产业的重要组成部分,是电子信息产业快速发展的先导,也是电子信息产业的重要支撑。随着电子信息产业的快速发展,PCB 行业的需求将持续增长。根据 PrismaK 统计,2018 年全球 PCB 行业总产值达 623.96 亿美元,同比增长 6.0%。预计 2018-2023 年全球 PCB 行业将保持 4.3%的复合增速,到 2023 年全球 PCB 行业产值将达到 770.09 亿美元。

2、本次发行的意义

1)本次发行的意义

PCB 行业主要分布在美国、日本、中国大陆、中国台湾等地区。2000 年以前,欧洲、亚洲和日本三大地区占据全球 PCB 生产 70%以上的产值,但近十年来,由于人才、资源、政策、产业集聚等方面的优势,全球电子制造业向中国转移,台湾和韩国等亚洲地区进行转移。自 2006 年开始,中国超越日本成为全球第一大 PCB 生产国家,PCB 的生产和产值均居世界第一,逐渐占有了全球 PCB 市场的半壁江山,中国已成为全球 PCB 行业的最大生产国,占全球 PCB 行业总产值的比例已占 2008 年的 31.18%,上升至 2019 年的 53.7%。根据 PrismaK 数据预测,未来五年中国仍将处于全球 PCB 行业生产第一的位置,且以高全球增长率增长的水平持续发展。基于中国庞大的内销市场和日益扩大的出口市场,预计未来几年,我国 PCB 行业仍将保持高速增长,并带动中国向全球 PCB 行业龙头迈进。

2)PCB 行业发展意义重大,具备坚实基础保障

电子信息产业是国民经济的战略性、基础性先导性支柱产业,是加快工业转型升级、国民经济和社会信息化建设的技术支撑和物质基础,是保障国防建设和国家信息安全的重要基石。PCB 行业作为电子信息产业的重要组成部分,是我国高度重视和大力支持发展的行业。我国相继出台了多项国家层面的产业政策,为行业发展提供了有力的政策支持和保障。

3、下游应用领域需求旺盛,带动 PCB 行业发展

PCB 的下游应用领域极为广泛,近年来,随着电子产品的发展,PCB 的应用范围不断拓宽,消费电子、汽车电子、计算机、医疗、航空国防等各个领域,其中通信电子、消费电子、计算机领域为 PCB 产品最大应用领域,合计占比超过 70%。根据 PrismaK 数据,2018 年全球三大领域市场需求为 480.22 亿美元,占比需求比例为 76.96%;2023 年该比例将继续保持稳定,预计将变为 75.87%。

伴随通信技术的快速发展以及 5G 商用化的逐步深入,PCB 在通信领域的应用将进一步深化。5G 通信技术的普及将促进通信设备的换代和重建,5G 建设将在未来 3-5 年显著推动 PCB 产业链景气度。5G 通讯将带动基站建设、智能穿戴及医疗设备等消费电子产品的不断升级,消费电子 PCB 市场前景广阔。5G 时代的到来也将带动在数据交换、数据传输、网络服务等下游领域的需求,促进服务器领域的升级,推动服务器 PCB 需求持续增长。同时,随着自动驾驶的普及和互联网汽车的快速发展,汽车电子市场空间巨大。智能化汽车电子产品占整车成本的比重有望超过 30%,汽车电子市场,将带动 PCB 行业市场规模的持续增长。

下游应用领域需求旺盛的需求为 PCB 行业发展提供了广阔的市场空间,也提出了更高的品质及生产标准,要求 PCB 产品品质达到下游产品的产能及更新换代。

1、非公开发行目的

1)非公开发行目的

近年来,随着消费电子、汽车电子、可穿戴设备、工业控制、医疗器械等下游领域新兴需求的不断涌现,为 PCB 行业发展提供了广阔的市场空间,同时下游应用领域的需求也促使 PCB 行业技术、生产、管理等方面的快速提升。当前,全球 PCB 行业正处于转型升级的关键时期,企业需要不断加大研发投入,提升产品品质,降低生产成本,丰富产品多样性,提高产品的综合竞争力。未来,在 PCB 行业快速发展的推动下,公司需要持续进行研发投入,不断提升研发创新能力,实现更高层次的生产技术储备,巩固核心竞争力。

2、缓解融资压力,改善提升资本实力

PCB 行业作为资本密集型行业,其前期投入和持续经营对于企业资金实力要求较高。随着投入和持续经营对于企业资金实力的要求,公司面临较大的资金压力。公司作为 PCB 行业的重要企业,拥有较强的市场竞争力,但公司过往的运营及研发投入,积累了大量的技术储备及客户资源,拥有一支经验丰富的研发团队,不同专业的核心骨干团队,确立了产品技术丰富、订单交货及时、客户管控高等竞争优势,并积极布局 5G 高频高速、通信模块、汽车电子、航空航天等领域,呈现良好的发展前景。为巩固提升核心竞争力,确立细分市场领先地位,公司需要及时补充运营资金,提高运营效率。

3、提升研发能力,加大研发投入,提升核心竞争力

公司作为 PCB 行业的重要企业,拥有较强的市场竞争力,但公司过往的运营及研发投入,积累了大量的技术储备及客户资源,拥有一支经验丰富的研发团队,不同专业的核心骨干团队,确立了产品技术丰富、订单交货及时、客户管控高等竞争优势,并积极布局 5G 高频高速、通信模块、汽车电子、航空航天等领域,呈现良好的发展前景。为巩固提升核心竞争力,确立细分市场领先地位,公司需要及时补充运营资金,提高运营效率。

4、提升研发能力,加大研发投入,提升核心竞争力

公司作为 PCB 行业的重要企业,拥有较强的市场竞争力,但公司过往的运营及研发投入,积累了大量的技术储备及客户资源,拥有一支经验丰富的研发团队,不同专业的核心骨干团队,确立了产品技术丰富、订单交货及时、客户管控高等竞争优势,并积极布局 5G 高频高速、通信模块、汽车电子、航空航天等领域,呈现良好的发展前景。为巩固提升核心竞争力,确立细分市场领先地位,公司需要及时补充运营资金,提高运营效率。

5、提升研发能力,加大研发投入,提升核心竞争力

公司作为 PCB 行业的重要企业,拥有较强的市场竞争力,但公司过往的运营及研发投入,积累了大量的技术储备及客户资源,拥有一支经验丰富的研发团队,不同专业的核心骨干团队,确立了产品技术丰富、订单交货及时、客户管控高等竞争优势,并积极布局 5G 高频高速、通信模块、汽车电子、航空航天等领域,呈现良好的发展前景。为巩固提升核心竞争力,确立细分市场领先地位,公司需要及时补充运营资金,提高运营效率。

6、提升研发能力,加大研发投入,提升核心竞争力

公司作为 PCB 行业的重要企业,拥有较强的市场竞争力,但公司过往的运营及研发投入,积累了大量的技术储备及客户资源,拥有一支经验丰富的研发团队,不同专业的核心骨干团队,确立了产品技术丰富、订单交货及时、客户管控高等竞争优势,并积极布局 5G 高频高速、通信模块、汽车电子、航空航天等领域,呈现良好的发展前景。为巩固提升核心竞争力,